



2100 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20037-3213 T 202.293.7060 F 202.293.7860

www.sughrue.com

# December 4, 2001

BOX PATENT APPLICATION Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

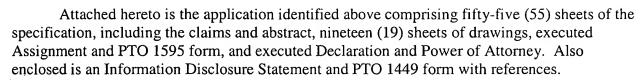
Re:

Application of Chiaki GOTO LASER LIGHT SOURCE

Assignee: FUJI PHOTO FILM CO., LTD.

Our Ref. Q66564

Dear Sir:



The Government filing fee is calculated as follows:

Total claims	70 - 20	=	50 x	\$18.00	=	\$900.00
Independent claims	1 - 3	=	x	\$84.00	=	\$.00
Base Fee						\$740.00
Multiple Dependent Claim Fee						\$280.00
TOTAL FILING FEE						\$1920.00
Recordation of Assignment						\$40.00
TOTAL FEE						\$1960.00

Checks for the statutory filing fee of \$1920.00 and Assignment recordation fee of \$40.00 are attached. You are also directed and authorized to charge or credit any difference or overpayment to Deposit Account No. 19-4880. The Commissioner is hereby authorized to charge any fees under 37 C.F.R. §§ 1.16 and 1.17 and any petitions for extension of time under 37 C.F.R. § 1.136 which may be required during the entire pendency of the application to Deposit Account No. 19-4880. A duplicate copy of this transmittal letter is attached.

Priority is claimed from:

Country

Application No

Filing Date

Japanese Patent

2000-372286

December 7, 2000

The priority document is enclosed herewith.

Respectfully submitted, SUGHRUE MION, PLLC

Attorpeys for Applicant

By: (1)

Registration No. 23,063

202-293-7060

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年12月 7日

出 願 番 号 Application Number:

特願2000-372286

出 顏 人 Applicant(s):

富士写真フイルム株式会社

1c760 U.S. PTO 10/000123 12/04/01

2001年 9月28日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

P25642J

【あて先】

特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】

H01L 33/00

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富士写真フィ

ルム株式会社内

【氏名】

後藤 千秋

【特許出願人】

【識別番号】

000005201

【氏名又は名称】

富士写真フイルム株式会社

【代理人】

【識別番号】 100073184

【弁理士】

【氏名又は名称】

柳田 征史

【選任した代理人】

【識別番号】

100090468

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐久間 剛

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008969

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9814441

要

【プルーフの要否】

【書類名】

1

明細書

【発明の名称】

レーザー光源

【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体発光素子と、この半導体発光素子から発せられた光の 被長を選択する波長選択素子を含む外部共振器とから構成されたレーザー光源に おいて、

前記半導体発光素子の劈開された2つの端面のうち前記外部共振器を構成しない端面に対して、該半導体発光素子のストライプが斜めに形成され、

この外部共振器を構成しない端面に、発振波長に対する反射防止コートが施されていることを特徴とするレーザー光源。

【請求項2】 前記波長選択素子として、波長選択した光を半導体発光素子に戻す機能を有するものが、該半導体発光素子の両側にそれぞれ1つずつ配置して用いられ、

これら2つの波長選択素子によって前記外部共振器が構成されていることを特徴とする請求項1記載のレーザー光源。

【請求項3】 前記波長選択素子として、波長選択した光を半導体発光素子に戻す機能を有するものが1つ用いられ、

この波長選択素子と、前記半導体発光素子の該波長選択素子と反対側の端面と によって前記外部共振器が構成されていることを特徴とする請求項1記載のレー ザー光源。

【請求項4】 前記ストライプが途中で曲げられて、半導体発光素子の前記 波長選択素子と反対側の端面に対して垂直に形成されていることを特徴とする請 求項3記載のレーザー光源。

【請求項5】 前記半導体発光素子または波長選択素子に光導波路素子が結合されていることを特徴とする請求項1から4いずれ1項記載のレーザー光源。

【請求項6】 前記波長選択素子として、波長選択した光を半導体発光素子に戻す機能を有するものが、該半導体発光素子の一方側に配置して用いられ、

前記半導体発光素子の他方側に光導波路素子が配設され、

この光導波路素子の前記半導体発光素子と反対側の端面と前記波長選択素子と

によって前記外部共振器が構成されていることを特徴とする請求項 5 記載のレーザー光源。

【請求項7】 前記光導波路素子が波長変換機能を有するものであることを 特徴とする請求項5または6記載のレーザー光源。

【請求項8】 前記波長選択素子による選択波長幅が、前記波長変換機能を有する光導波路素子の位相整合許容波長幅とほぼ同等であることを特徴とする請求項5から7いずれか1項記載のレーザー光源。

【請求項9】 前記光導波路素子が外部共振器の中に配置されていることを 特徴とする請求項5から8いずれか1項記載のレーザー光源。

【請求項10】 前記光導波路素子の外部共振器を構成する端面が、その光 導波路の延びる方向に対して垂直にカットされていることを特徴とする請求項9 記載のレーザー光源。

【請求項11】 前記光導波路素子の外部共振器を構成しない端面が、その 光導波路の延びる方向に対して斜めにカットされていることを特徴とする請求項 9記載のレーザー光源。

【請求項12】 前記半導体発光素子または波長選択素子と光導波路素子と が直接結合されていることを特徴とする請求項5から11いずれ1項記載のレー ザー光源。

【請求項13】 前記波長選択素子が、光導波路部分に反射型ブラッグ・グレーティングを有する導波路型波長選択素子であることを特徴とする請求項1から12いずれか1項記載のレーザー光源。

【請求項14】 前記波長選択素子と半導体発光素子とが直接結合されていることを特徴とする請求項13記載のレーザー光源。

【請求項15】 前記外部共振器が、半導体発光素子の一端面と向き合わせて配置されたミラーと、該半導体発光素子の他端面とによって構成され、

前記波長選択素子が、前記ミラーと半導体発光素子との間に配置された狭帯域 バンドパスフィルターからなることを特徴とする請求項1記載のレーザー光源。

【請求項16】 前記半導体発光素子を高周波重畳して駆動する駆動回路を有することを特徴とする請求項1から15いずれか1項記載のレーザー光源。

【請求項17】 前記外部共振器の縦モード間隔が前記波長選択素子の選択 波長幅より小さく、前記高周波重畳によって前記選択波長幅内にあるマルチ縦モードで動作するように構成されたことを特徴とする請求項1から16いずれか1 項記載のレーザー光源。

【請求項18】 前記外部共振器を構成する要素を所定温度に保つ温度調節 手段を有することを特徴とする請求項1から17いずれか1項記載のレーザー光 源。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

# 【発明の属する技術分野】

本発明はレーザー光源に関し、特に詳細には、半導体発光素子から発せられた 光を、波長選択素子を含む外部共振器によって波長選択しつつ発振させるように したレーザー光源に関するものである。

[0002]

# 【従来の技術】

従来、例えば特開平10-254001号公報に示されるように、半導体レーザー等の半導体発光素子に狭帯域バンドパスフィルター等の波長選択素子を備えた外部共振器を組み合わせた構成を有し、この外部共振器の作用によって発振するレーザービームの波長を所望波長にロックするレーザー光源が公知となっている。ここで上記の外部共振器は、通常のミラーや、その他、例えば特願2000-196166号明細書に示されるように、光導波路に沿って形成した反射型ブラッグ・グレーティングにより導波光を波長選択しつつ反射回折させる導波路型の素子等を用いて構成することができる。

[0003]

図17は、上記導波路型の素子を備えたレーザー光源の一例を示すものである。このレーザー光源は、半導体レーザーチップ1と、この半導体レーザーチップ1の劈開された一端面1aに直接接合された導波路型波長選択素子2とから構成されている。半導体レーザーチップ1は活性領域を含むストライプ3を有し、このストライプ3はチップ端面1a、1bに対して垂直に形成されている。波長選

択素子2は、強誘電体基板にチャンネル光導波路4が形成され、このチャンネル 光導波路4における光伝搬方向に沿ってDBR(分布ブラッグ反射型)グレーティング5が形成されてなるものである。

[0004]

そして半導体レーザーチップ1の端面1 a および、波長選択素子2の両端面2 a、2 b にはそれぞれAR(反射防止)コートが、また半導体レーザーチップ1 の別の端面1 b にはHR(高反射)コートが施されている。

[0005]

上記構成のレーザー光源においては、半導体レーザーチップ1から発せられた 光が波長選択素子2のチャンネル光導波路4に入射し、DBRグレーティング5 によおいて反射回折する。そこで、このDBRグレーティング5と、半導体レー ザーチップ1のHRコートが施された端面1bとによって外部共振器が構成され 、該外部共振器で共振したレーザービーム6が波長選択素子2の端面2bから出 射する。そして、DBRグレーティング5において反射回折する光の波長がグレ ーティング周期に対応して選択されるので、発振波長が、半導体レーザーチップ 1の発光ゲインの中の所望値に選択、ロックされる。

[0006]

また上記特開平10-254001号公報には、半導体発光素子に光波長変換素子を結合し、発振したレーザービームをこの光波長変換素子によって第2高調波等に波長変換する技術も示されている。この光波長変換素子としては、例えば、非線形光学効果を有する強誘電体結晶基板に一方向に延びる光導波路が形成されるとともに、この光導波路に基板の自発分極の向きを反転させたドメイン反転部が周期的に形成されてなり、該光導波路においてドメイン反転部の並び方向に導波する基本波を波長変換するものが知られている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、上述のように波長選択素子を備えた外部共振器を半導体発光素子に 組み合わせてなるレーザー光源においては、半導体発光素子の波長選択素子側の 端面に、比較的容易に形成され得る反射率0.1%程度のAR(反射防止)コート

を施しても、そこでの残存反射により半導体発光素子のファブリペローモードが 立ちやすく、そのため、外部共振器で選択される縦モードに影響が及んで発振波 長が不安定になるという問題が認められている。

# [0008]

具体的には、波長選択素子から半導体発光素子への帰還光とは異なる波長で発振したり、外部共振器による縦モードと複合共振器(半導体発光素子の両端面で構成されるファブリペロー共振器と外部共振器とで構成される)による縦モードとの間でモードホップが生じたりすることがある。さらには、このモードホップの対策として半導体発光素子を高周波重畳をかけて駆動すると、それが外乱となって、波長選択素子から半導体発光素子への帰還光とは異なる波長で発振することもある。

# [0009]

この問題は特に、髙出力を得るために半導体発光素子に髙電流を注入する場合 、や、半導体発光素子の素子長が比較的長くてゲインが大きくなっている場合に生 じやすい。

### [0010]

なお図18は、上記モードホップによって光出力が変動する様子を概略的に示すものである。また図19は発振スペクトルを概略的に示すものであり、(1)は 比較的低出力時の状態を、また(2)比較的高出力時の状態を示している。

# [0011]

以上の問題を解決するために、例えば文献Appl.Phys.Lett.47(3),1,August 19 85,pp.183-185に示されるように、実質的に外部共振器による選択波長のみで発振可能にしたレーザー光源も提案されている。このレーザー光源は、半導体発光素子と波長選択機能を持つ外部共振器とを直接結合し、そして、それらの直接結合される端面には選択される波長に対してAR(反射防止)コートを施したものである。そのようにすると、半導体発光素子の両端面でファブリペローモードが立ち難くなくなるので、外部共振器のみによってレーザービームが発振しやすくなる。

#### [0012]

しかし、そのような構成を採用しても、半導体発光素子の両端面でファブリペローモードが立つことを完全に防止するのは困難になっている。

[0013]

本発明は上記の事情に鑑みてなされたものであり、半導体発光素子と、この半 導体発光素子から発せられた光の波長を選択する波長選択素子を含む外部共振器 とから構成されたレーザー光源において、選択された波長で安定して発振可能と することを目的とする。

[0014]

# 【課題を解決するための手段】

本発明によるレーザー光源は、半導体発光素子と、この半導体発光素子から発せられた光の波長を選択する波長選択素子を含む外部共振器とから構成されたレーザー光源において、半導体発光素子の劈開された2つの端面のうち外部共振器を構成しない端面に対して、該半導体発光素子のストライプが斜めに形成され、そしてこの外部共振器を構成しない端面に、発振波長に対する反射防止コートが施されていることを特徴とするものである。

#### [0015]

なお上記2つの端面は、1つが外部共振器を構成する場合もあるし、2つとも外部共振器を構成しない場合もある。前者の場合は、外部共振器を構成しない方の端面に対してストライプを斜めに形成すればよいし、後者の場合は、2つの端面双方に対して、あるいは一方の端面のみに対してストライプを斜めに形成すればよい。

# [0016]

また本発明のレーザー光源において、より具体的には、波長選択素子として、 波長選択した光を半導体発光素子に戻す機能を有するものが、該半導体発光素子 の両側にそれぞれ1つずつ配置して用いられ、これら2つの波長選択素子によっ て外部共振器が構成されるのが望ましい。

#### [0017]

あるいは、波長選択素子として、波長選択した光を半導体発光素子に戻す機能 を有するものが1つ用いられた上で、この波長選択素子と、半導体発光素子の波

長選択素子と反対側の端面とによって外部共振器が構成されてもよい。

[0018]

その場合、半導体発光素子のストライプは、半導体発光素子の波長選択素子と 反対側の端面、つまり外部共振器を構成する端面に対して垂直となるように、途 中で曲げられていることが望ましい。

[0019]

以上のように1つの波長選択素子と半導体発光素子とによって、あるいは2つの波長選択素子によって外部共振器が構成される場合、それらの半導体発光素子または波長選択素子に対して、例えば波長変換機能を有する光導波路素子が結合されてもよい。

[0020]

さらには、波長選択素子として、波長選択した光を半導体発光素子に戻す機能 を有するものが、該半導体発光素子の一方側に配置して用いられ、

半導体発光素子の他方側に光導波路素子が配設され、

この光導波路素子の半導体発光素子と反対側の端面と、波長選択素子とによって外部共振器が構成されてもよい。この場合も光導波路素子としては、波長変換機能を有するものが好適に用いられる。

[0021]

光導波路素子として波長変換機能を有するものを用いる場合、波長選択素子による選択波長幅は、この波長変換における位相整合許容波長幅とほぼ同等とされるのが望ましい。

[0022]

そして上述のような光導波路素子は、外部共振器の中に配置されることが望ま しい。

[0023]

また上記光導波路素子において、半導体発光素子と反対側の端面、つまり外部 共振器を構成する端面は、その光導波路の延びる方向に対して垂直にカットされ ていることが望ましい。

[0024]

また、上述のような光導波路素子において、光導波路素子の外部共振器を構成 しない端面が、その光導波路の延びる方向に対して斜めにカットされていること が望ましい。

[0025]

そして上述のような光導波路素子は、半導体発光素子または波長選択素子と直接結合されていることが望ましい。

[0026]

また波長選択素子としては、光導波路部分に前述の反射型ブラッグ・グレーティングを有する導波路型波長選択素子を好適に用いることができる。そのような導波路型波長選択素子あるいは上記光導波路素子と半導体発光素子とは、互いに直接結合されるのが望ましい。それは、導波路型波長選択素子と光導波路素子との結合についても同様である。この「直接結合」とは、2つの素子が、互いにレンズ光学系を介さないで結合されていることを指すものであり、結合される要素が物理的に互いに直接接していない場合も含むものである。

[0027]

また、本発明のレーザー光源においては、半導体発光素子の一端面と向き合わせて配置されたミラーと、該半導体発光素子の他端面とによって外部共振器が構成された上で、波長選択素子として、上記ミラーと半導体発光素子との間に配置された狭帯域バンドパスフィルターが用いられてもよい。

[0028]

他方、本発明のレーザー光源においては、半導体発光素子を高周波重畳して駆動する駆動回路が設けられることが望ましい。そしてその場合は、外部共振器の縦モード間隔が波長選択素子の選択波長幅より小さく、高周波重畳によって上記選択波長幅内にあるマルチ縦モードで動作するように構成されるのが望ましい。

[0029]

さらに本発明のレーザー光源においては、外部共振器を構成する要素を所定温 度に保つ温度調節手段が設けられることが望ましい。

[0030]

【発明の効果】

本発明のレーザー光源においては、半導体発光素子の劈開された2つの端面の うち外部共振器を構成しない端面に、発振波長に対する反射防止コートが施され たことにより、これら2つの端面間での光閉じ込めが弱くなり、ファブリペロー モードが立ち難くなくなる。

#### [0031]

その上さらに、外部共振器を構成しない端面に対して半導体発光素子のストライプが斜めに形成されたことにより、ストライプ部分を導波した光がその斜めに形成された端面で反射する際に、導波して来た方向とは別の向きに反射するようになるので、この端面と別の端面との間でファブリペローモードがさらに立ち難くなくなる。そこで本発明のレーザー光源は、外部共振器のみによって発振しやすくなり、そこに含まれる波長選択素子によって選択された波長で安定して発振可能となる。

[0032]

# 【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。図1は、本発明の第1 の実施形態によるレーザー光源の平面形状を示すものである。

[0033]

図示されるようにこの第1の実施形態のレーザー光源は、レーザービーム11を発するための半導体発光素子である半導体レーザーチップ10と、この半導体レーザーチップ10の劈開された一端面10a、他端面10b側にそれぞれ直接接合された導波路型の波長選択素子20、120とから構成されている。

[0034]

半導体レーザーチップ10は活性領域を含む光導波路からなるストライプ12を有し、波長1060 n mにゲインピークを有する。また上記端面10 a、端面10 b にはそれぞれ、波長1060 n mに対して反射率0.5%以下となるAR(反射防止)コートが施されている。この半導体レーザーチップ10の素子長は一例として0.75 m m、その光導波路の実効屈折率は3.35である。

[0035]

そしてこの半導体レーザーチップ10のストライプ12は、端面10aおよび端面10

bに対して斜めに形成されている。本実施形態では、このストライプ12の延びる 方向は、端面10 a および端面10に垂直な方向に対して一例として3°傾けられて いる。

[0036]

第1の波長選択素子20は、例えば $SiO_2$ 基板21に $Si_3O_4$ のチャンネル光導波路 $2^2$ が形成され、そしてこのチャンネル光導波路22における光伝搬方向に沿ってDBR(分布ブラッグ反射型)グレーティング23が形成されてなるものである。

[0037]

ここでDBRグレーティング23のピッチAglは、導波光の波長をλ、チャンネル光導波路22の実効屈折率をNeffとすると

 $\Lambda gl = q \lambda / 2 Neff \quad (q = 1, 2, 3, \dots)$ 

である。本例ではq=1、 $\lambda=1060\,n\,m$ 、Neff=1.53 として、 $\Lambda g1=346\,n\,m$  に設定されている。それによりこのDBRグレーティング23は、波長 $\lambda=1060\,n\,m$ の光のみを選択的に反射回折させるものとなる。またこの第1の波長選択素子 20の素子長は $6\,m\,m$ でグレーティング長も $6\,m\,m$ であり、 $DBRグレーティング23における波長<math>1060\,n\,m$ に対する反射率は90%である。一般にこの反射率は、90%以上に設定するのが望ましい。

[0038]

そしてこの第1の波長選択素子20の半導体レーザーチップ10に直接結合される 端面20 a と、それと反対側の端面20 b にはそれぞれ、波長1060 n mに対して反射 率0.5%以下となるAR(反射防止)コートが施されている。

[0039]

第2の波長選択素子120も、上述した $SiO_2$ 基板21と同様の $SiO_2$ 基板121に $Si_3O_4$ のチャンネル光導波路122が形成され、そしてこのチャンネル光導波路122における光伝搬方向に沿ってDBRグレーティング123が形成されてなるものである。

[0040]

ここでチャンネル光導波路122の実効屈折率Neff は、第1の波長選択素子20

のチャンネル光導波路22と同様に1.53であり、したがってDBRグレーティング123のピッチ Λg2も同様に Λg2=346 n mとされている。それによりこのDBRグレーティング123は、波長 λ = 1060 n mの光のみを選択的に反射回折させるものとなる。またこの波長選択素子120の素子長は 2 mm、グレーティング長は素子長の半分の 1 mmであり、DBRグレーティング123における波長1060 n mに対する反射率は15%である。一般にこの反射率は、5~30%程度の範囲内に設定するのが望ましい。

# [0041]

そしてこの波長選択素子120の半導体レーザーチップ10に直接結合される端面120 bと、それと反対側の端面120 a にはそれぞれ、波長1060 n mに対してこれも反射率0.5%以下となるAR(反射防止)コートが施されている。

# [0042]

上述した通り半導体レーザーチップ10のストライプ12は、端面10 a および端面10 b に対して斜めに形成されているが、本実施形態では、このストライプ12を導波する光と第1の波長選択素子20のチャンネル光導波路22を導波する光との間でスネルの法則が満足されるように、チャンネル光導波路22も素子端面20 a に対して斜めに形成されている。

#### [0043]

すなわち、端面10 a に垂直な方向に対するストライプ12の傾き角は前述した通り3°、このストライプ12を構成する光導波路の実効屈折率は3.35、チャンネル光導波路22の実効屈折率は1.53 であるから、素子端面20 a に垂直な方向に対するチャンネル光導波路22の傾き角を6.58°とすると、スネルの法則が満足される

# [0044]

さらに、ストライプ12を導波する光と、第2の波長選択素子120のチャンネル 光導波路122を導波する光との間でスネルの法則が満足されるように、チャンネ ル光導波路122も素子端面120bに対して斜めに形成されている。ここで、素子端 面120bに垂直な方向に対するチャンネル光導波路122の傾き角は、上記と同じよ うに6.58°である。

# [0045]

また、第1の波長選択素子20は、そのチャンネル光導波路22を導波する光のモードフィールド径が、半導体レーザーチップ10の発光のモードフィールド径とほぼ同等となる構成とされている。第2の波長選択素子120も、そのチャンネル光導波路122を導波する光のモードフィールド径が、半導体レーザーチップ10の発光のモードフィールド径とほぼ同等となる構成とされている。そのような構成とすることにより、半導体レーザーチップ10と第1の波長選択素子20との間、そして半導体レーザーチップ10と第2の波長選択素子120との間の導波光の結合効率を、最大限高くすることができる。

#### [0046]

第1の波長選択素子20と半導体レーザーチップ10とは、チャンネル光導波路22の端面とストライプ12の端面どうしが対面して、端面20 a と端面10 a とが互いに近接する状態に配設されている。このときの端面20 a と端面10 a との間の距離は1.5 μ m以下とされる。なお、第1の波長選択素子20と半導体レーザーチップ10とは、端面20 a と端面10 a とが密接する状態に配設されてもよい。このように第1の波長選択素子20と半導体レーザーチップ10とを配設することにより両者は、各々における導波光が結合する直接結合(butt coupling)状態となる。

# [0047]

また第2の波長選択素子120と半導体レーザーチップ10も、チャンネル光導波路122の端面とストライプ12の端面どうしが対面して、端面120 b と端面10 b とが互いに近接する状態に配設されている。端面120 b と端面10 b との間の距離は1.5 μ m以下とされる。なお、波長選択素子120と半導体レーザーチップ10とは、端面120 b と端面10 b とが密接する状態に配設されてもよい。このように波長選択素子120と半導体レーザーチップ10とを配設することにより両者は、各々における導波光が結合する直接結合 (butt coupling) 状態となる。

#### [0048]

以下、このレーザー光源の作用について説明する。半導体レーザーチップ10のストライプ12からは、中心波長1060 n mの光が両方向に発せられる。半導体レーザーチップ10の端面10 a から出射したこの光は第1の波長選択素子20の光導波路

22内に入射してそこを導波し、DBRグレーティング23で反射回折して半導体レーザーチップ10に戻る。このとき、DBRグレーティング23の波長選択作用により、反射回折する光の波長が選択される。また、半導体レーザーチップ10の端面10bから出射したこの光は第2の波長選択素子120の光導波路122内に入射してそこを導波し、DBRグレーティング123で反射回折して半導体レーザーチップ10に戻る。このときも、DBRグレーティング123の波長選択作用により、反射回折する光の波長が選択される。

#### [0049]

以上のように第1の波長選択素子20と第2の波長選択素子120との間で光が折り返すことにより、これらの波長選択素子20および120の間でこの光が共振し、発振したレーザービーム11が得られる。このレーザービーム11の一部は、反射率が比較的低く設定された第2の波長選択素子120のDBRグレーティング123を通過し、この第2の波長選択素子120の端面120aから出射する。

# [0050]

そして、DBRグレーティング23および123において反射回折する光の波長が 選択されるので、発振波長を、半導体レーザーチップ10の発光ゲインの中の所望 値に選択、ロックすることができる。

#### [0051]

特に本レーザー光源においては、半導体レーザーチップ10の端面10 a および第 1 の波長選択素子20の端面20 a に A R コートが施され、また半導体レーザーチップ10の端面10 b および第 2 の波長選択素子120の端面120 b にも A R コートが施され、その上、半導体レーザーチップ10の端面10 a および10 b に対してストライプ12が斜めに形成されているので、実質的に、半導体レーザーチップ10の両端面10 a、10 b 間でファブリペローモードが立つことがなくなる。その詳しい理由は、先に述べた通りである。

#### [0052]

それに加えて、第1の波長選択素子20の端面20bおよび第2の波長選択素子120の端面120aにもARコートが施されているので、実質的に、半導体レーザーチップ10の端面10bと第1の波長選択素子20の端面20bとの間や、半導体レーザー

チップ10の端面10aと第2の波長選択素子120の端面120aとの間でファブリペローモードが立つこともなくなる。

# [0053]

つまり本レーザー光源においては、レーザービーム11を反射回折させるDBR グレーティング23および123の間でファブリペロー型の外部共振器が構成され、 実質的にこの共振器のみによってレーザービーム11が発振し、その発振波長はこの共振器による選択波長となる。なお図1には、この外部共振器が構成されている範囲を矢印しで示してある(以下、同様)。

# [0054]

より具体的に、本実施形態のレーザー光源では、幅広い出力範囲において、特に高出力時にも、波長選択素子20および120による選択波長以外の波長での発振は観察されず、発振波長を安定に制御することができた。つまり、幅広い注入電流範囲において、単一縦モードで駆動できた。

# [0055]

なお本実施形態において、2つの波長選択素子20、120間の共振器モードの縦 モード間隔は約0.1nmである。一方DBRグレーティング23および123の選択波 長幅は、図4にその波長選択性を示す通り、FWHM(半値全幅)で0.12nmと、上 記縦モード間隔とほぼ同等にした。また、レーザー光源の出力光を波長変換する 場合は、波長変換の位相整合許容波長幅に対して、出力光の波長幅を同等以下と するのが望ましい。

#### [0056]

図2の(1)、(2)にはそれぞれ、本実施形態のレーザー光源を高周波重畳せずに通常に駆動した際の駆動電流対光出力特性と、発振スペクトルとを概略的に示してある。電流注入による共振器長変化に起因する縦モードのホップは比較的スムーズであり、そのため同図(1)に示される通り、モードホップによる出力変動は小さく抑えられ、出力が安定する電流範囲を比較的広く確保することができる。また、この図2の(2)と、前述した図19の(1)および(2)とを比べれば、本実施形態のレーザー光源が単一縦モードで安定して駆動していることが分かる。

[0057]

また図3の(1)、(2)にはそれぞれ、本実施形態のレーザー光源を高周波重畳駆動した際の駆動電流対光出力特性と、発振スペクトルとを概略的に示してある。同図の(1)から明確に分かる通り駆動電流対光出力特性は、図2(1)の高周波重畳駆動しない場合と比べると、モードホップによる光出力の変動も抑制されて、安定したものとなっている。このように高周波重畳駆動しても、図19の(2)に示した従来装置の場合とは異なり、モード切り替わり時のみ図3(3)のようになるが、それ以外では選択波長以外の波長で発振することはなく、図3(2)に示す通り単一縦モードで安定して駆動可能となっている。

# [0058]

この第1実施形態のレーザー光源においては、半導体レーザーチップ10の両側に配した2つの波長選択素子20、120で外部共振器を構成しているので、特に強い波長選択性が得られる。

# [0059]

なお本実施形態では波長選択素子として、特願2000-085973号および同2000-085974号明細書に開示されているような $SiO_2$ 基板にチャンネル光導波路およびDBRグレーティングが形成されてなるものを用いたが、その他例えば、MgO-LN ( $MgOがドープされたLiNbO_3$ ) 基板にチャンネル光導波路およびDBRグレーティングを形成してなる波長選択素子を用いることもできる。

# [0060]

次に、上記第1実施形態のレーザー光源を実装してなる光源装置について、その概略側面形状を示す図5を参照して説明する。図示される通り本光源装置においては、レーザー光源の半導体レーザーチップ10、第1の波長選択素子20および第2の波長選択素子120が、それぞれ銅等の熱伝導性の高い金属からなるブロック41、42、43に保持されている。そして金属ブロック42および43は金属ブロック41に固定され、この金属ブロック41がペルチェ素子50の上面(温度制御面)上に固定されている。

# [0061]

ここでブロック41とブロック42との相対位置、そしてブロック41とブロック43

との相対位置は、半導体レーザーチップ10のストライプ12とチャンネル光導波路 22および122との間で導波光が最大効率で結合するように調整、固定される。

# [0062]

また、第2の波長選択素子120から発散光状態で出射したレーザービーム11を 平行光化するコリメーターレンズ45と、平行光化されたレーザービーム11の一部 を分岐させるビームスプリッタ46と、分岐されたレーザービーム11の強度を検出 するフォトダイオード等からなる光検出器51とが設けられている。

# [0063]

以上説明した各要素は、埃等の影響を避けるために、パッケージベース60およびそれに被着されたパッケージカバー61からなるパッケージ内に収納されている。ビームスプリッタ46を透過したレーザービーム11は、パッケージカバー61に設けられた窓ガラス62を透過してパッケージ外に出射し、所定の用途に用いられる

#### [0064]

また、波長選択素子20、120の各DBRグレーティング23、123によって構成される外部共振器の近傍の温度を検出するサーミスタ52が設けられ、このサーミスタ52の温度検出信号S1は温度制御回路53に入力される。温度制御回路53はこの温度検出信号S1に対応したペルチェ素子駆動制御信号S2をペルチェ素子50に入力して、該ペルチェ素子50の駆動を制御する。それにより、上記外部共振器の近傍の温度が一定に保たれ、温度変化に伴う共振器長変化に起因する発振波長の変動が確実に防止される。

#### [0065]

また上記光検出器51が出力する光強度検出信号S3は、半導体レーザー駆動制御回路54にフィードバック(帰還)される。半導体レーザー駆動制御回路54はこの光強度検出信号S3に基づいて、半導体レーザーチップ10に供給する駆動電流S4の値を変化させ、それによりレーザービーム11の光出力を所定の値に制御する。

# [0066]

そこでこの光源装置においては、幅広い注入電流範囲において単一縦モード駆

動できるので、レーザービーム11の光出力を所定の値に制御するために駆動電流 S4の値が変化しても、モードホップが生じることがなくなり、このモードホッ プによるノイズの発生が防止される。

# [0067]

この光源装置を階調画像形成装置の記録用光源等に適用する場合においては、 高周波重畳駆動で直接変調動作させた際の変調出力の再現性も極めて良好なもの となる。

#### [0068]

次に図6を参照して、本発明の第2の実施形態によるレーザー光源について説明する。なおこの図6において、図1中の要素と同等の要素には同番号を付してあり、それらについての重複した説明は省略する(以下、同様)。

# [0069]

この第2の実施形態のレーザー光源は、図1に示した第1実施形態のものと比較すると、半導体レーザーチップ10の端面10bに、第2の波長選択素子120に代えて光導波路素子130が直接結合されている点が異なるものであって、その他の構成は基本的に図1のものと同様とされている。

# [0070]

光導波路素子130は、MgO-LN基板131にチャンネル光導波路132が形成されてなるものである。このチャンネル光導波路132の実効屈折率は、一例として2.2である。

# [0071]

そしてこの光導波路素子130の半導体レーザーチップ10に直接結合される端面130 bには、発振波長1060 n mに対して反射率0.5%以下となるAR(反射防止)コートが施されている。一方、光導波路素子130の反対側の端面130 a には、発振波長1060 n mに対して反射率5~30%程度となるLR(低反射)コートが施されている。

#### [0072]

ここでも半導体レーザーチップ10のストライプ12は、端面10 a および端面10 b に対して斜めに形成されているが、本実施形態では、このストライプ12を導波す

る光と光導波路素子130のチャンネル光導波路132を導波する光との間でスネルの 法則が満足される傾き角として、チャンネル光導波路132も素子端面130 b に対し て斜めに形成されている。

# [0073]

一方、光導波路素子130の別の端面130aは、そこで反射した導波光が進行して 来た方向と正反対の方向に折り返すように、チャンネル光導波路132に対して垂 直にカットされている。

# [0074]

また、光導波路素子130は、そのチャンネル光導波路132を導波する光のモード フィールド径が、半導体レーザーチップ10の発光のモードフィールド径とほぼ同 等となる構成とされている。そのような構成とすることにより、半導体レーザー チップ10と光導波路素子130との間の導波光の結合効率を、最大限髙くすること ができる。

# [0075]

光導波路素子130と半導体レーザーチップ10とは、チャンネル光導波路132の端 面とストライプ12の端面どうしが対面して、端面130bと端面10bとが互いに近 接する状態に配設されている。端面130bと端面10bとの間の距離は1.5μm以下 とされる。なお、光導波路素子130と半導体レーザーチップ10とは、端面130 b と 端面10bとが密接する状態に配設されてもよい。このように光導波路素子130と 半導体レーザーチップ10とを配設することにより両者は、各々における導波光が 結合する直接結合 (butt coupling) 状態となる。

#### [0076]

以下、このレーザー光源の作用について説明する。半導体レーザーチップ10の ストライプ12からは、中心波長1060mmの光が両方向に発せられる。半導体レー ザーチップ10の端面10aから出射したこの光は波長選択素子20の光導波路22内に 入射してそこを導波し、DBRグレーティング23で反射回折して半導体レーザー チップ10に戻る。このとき、DBRグレーティング23の波長選択作用により、反 射回折する光の波長が選択される。また、半導体レーザーチップ10の端面10bか ら出射したこの光は光導波路素子130の光導波路132内に入射してそこを導波し、

1 8

一部が素子端面130 a で反射して半導体レーザーチップ10に戻る。

# [0077]

以上のように波長選択素子20のDBRグレーティング23と光導波路素子130の端面130 a との間で光が折り返すことにより、該DBRグレーティング23および端面130 a の間でこの光が共振し、発振したレーザービーム11が得られる。このレーザービーム11の一部は、反射率が比較的低く設定された光導波路素子130の端面130 a から出射する。

# [0078]

そしてこの場合も、DBRグレーティング23において反射回折する光の波長が 選択されるので、発振波長を、半導体レーザーチップ10の発光ゲインの中の所望 値に選択、ロックすることができる。

# [0079]

特に本レーザー光源においては、半導体レーザーチップ10の端面10 a および波 長選択素子20の端面20 a にARコートが施され、また半導体レーザーチップ10の 端面10 b および光導波路素子130の端面130 b にもARコートが施され、その上、 半導体レーザーチップ10の端面10 a および10 b に対してストライプ12が斜めに形 成されているので、実質的に、半導体レーザーチップ10の両端面10 a、10 b 間で ファブリペローモードが立つことがなくなる。その詳しい理由は、先に述べた通 りである。

#### [0080]

それに加えて、波長選択素子20の端面20bおよび光導波路素子130の端面130aにもARコートが施されているので、実質的に、半導体レーザーチップ10の端面10bと波長選択素子20の端面20bとの間や、半導体レーザーチップ10の端面10aと光導波路素子130の端面130aとの間でファブリペローモードが立つこともなくなる。

#### [0081]

つまり本レーザー光源においては、レーザービーム11を反射回折させるDBR グレーティング23と、光導波路素子130の端面130aとの間でファブリペロー型の 外部共振器が構成され、実質的にこの共振器のみによってレーザービーム11が発

振し、その発振波長はこのDBRグレーティング23による選択波長となる。

[0082]

なお本実施形態では光導波路素子130として、MgO-LN基板131にチャンネル光導波路132を形成してなるものを用いたが、ここでも、前述のSiまたは石英基板に屈折率が1.75~2.3程度のコア材料からなるチャンネル光導波路を形成してなる光導波路素子を用いることもできる。

[0083]

次に図7を参照して、本発明の第3の実施形態によるレーザー光源について説明する。この第3の実施形態のレーザー光源は、図6に示した第2実施形態のものと比較すると、半導体レーザーチップ10の端面10bに、光導波路素子130に代えて導波路型の光波長変換素子30が直接結合されている点が異なるものであって、その他の構成は基本的に図6のものと同様とされている。

[0084]

光波長変換素子30は、非線形光学効果を有するMgO-LN基板31に、そのZ軸と平行な自発分極の向きを反転させたドメイン反転部33が周期的に形成されてなる周期ドメイン反転構造と、この周期ドメイン反転構造に沿って延びるチャンネル光導波路32が形成されてなるものである。このチャンネル光導波路32の実効屈折率は、一例として2.2である。

[0085]

そしてこの光波長変換素子30の半導体レーザーチップ10に直接結合される端面30 b には、波長1060 n mのレーザービーム11に対して反射率0.5%以下となるAR(反射防止)コートが施されている。一方、光波長変換素子30の反対側の端面30 a には、レーザービーム11に対してHR(高反射)となり、後述する第2高調波15に対してはARとなるコートが施されている。

[0086]

ここでも半導体レーザーチップ10のストライプ12は、端面10 a および端面10 b に対して斜めに形成されているが、本実施形態では、このストライプ12を導波する光と光波長変換素子30のチャンネル光導波路32を導波する光との間でスネルの法則が満足される傾き角として、チャンネル光導波路32も素子端面30 b に対して

斜めに形成されている。

[0087]

一方、光波長変換素子30の別の端面30 a は、そこで反射した導波光が進行して来た方向と正反対の方向に折り返すように、チャンネル光導波路32に対して垂直にカットされている。

[0088]

また、光波長変換素子30は、そのチャンネル光導波路32を導波する光のモードフィールド径が、半導体レーザーチップ10の発光のモードフィールド径とほぼ同等となる構成とされている。そのような構成とすることにより、半導体レーザーチップ10と光波長変換素子30との間の導波光の結合効率を、最大限高くすることができる。

[0089]

光波長変換素子30と半導体レーザーチップ10とは、チャンネル光導波路32の端面とストライプ12の端面どうしが対面して、端面30 b と端面10 b とが互いに近接する状態に配設されている。端面30 b と端面10 b との間の距離は1.5 μ m以下とされる。なお、光波長変換素子30と半導体レーザーチップ10とは、端面30 b と端面10 b とが密接する状態に配設されてもよい。このように光波長変換素子30と半導体レーザーチップ10とを配設することにより両者は、各々における導波光が結合する直接結合(butt coupling) 状態となる。

[0090]

以下、このレーザー光源の作用について説明する。半導体レーザーチップ10のストライプ12からは、中心波長1060 n mの光が両方向に発せられる。半導体レーザーチップ10の端面10 a から出射したこの光は波長選択素子20の光導波路22内に入射してそこを導波し、DBRグレーティング23で反射回折して半導体レーザーチップ10に戻る。このとき、DBRグレーティング23の波長選択作用により、反射回折する光の波長が選択される。また、半導体レーザーチップ10の端面10 b から出射したこの光は光波長変換素子30の光導波路32内に入射してそこを導波し、大部分が素子端面30 a で反射して半導体レーザーチップ10に戻る。

[0091]

以上のように波長選択素子20のDBRグレーティング23と光波長変換素子30の端面30 a との間で光が折り返すことにより、該DBRグレーティング23および端面30 a の間でこの光が共振し、発振したレーザービーム11が得られる。このレーザービーム11は、光波長変換素子30に基本波として入射し、前述の周期ドメイン反転構造によって疑似位相整合が取られて、波長が1/2の第2高調波15に変換される。この第2高調波15は、光波長変換素子30の端面30 a から出射する。

# [0092]

この第3の実施形態においても、幅広い出力範囲において、特に高出力時にも、波長選択素子20による選択波長以外の波長での発振は観察されず、発振波長を安定に制御することができた。つまり、幅広い注入電流範囲において、発振波長を波長変換の波長許容幅内に制御できた。

# [0093]

なお本実施形態において、外部共振器の縦モード間隔は約0.02nmである。一方DBRグレーティング23の選択波長幅はFWHM(半値全幅)で0.12nmであり、 光波長変換素子30の波長変換における位相整合許容波長幅は同様に0.12nmである。本例においては、基本波であるレーザービーム11の発振波長が、この波長変換における位相整合許容波長幅内で安定しているので、安定した出力の第2高調波15を得ることができる。また、光波長変換素子30を外部共振器の中に配置しているので、外部共振器の縦モード間隔を狭くすることができ、それにより、安定したマルチモード発振が可能になる。

# [0094]

ここで、本実施形態のレーザー光源を高周波重畳駆動した際の駆動電流と第2高調波光出力との関係を図8に、発振スペクトルを図9にそれぞれ概略的に示す。図8に示されている通り、第2高調波光出力はモードホップによる不連続な出力変化も抑制されて、安定したものとなっている。また図9に示されている通り、このレーザー光源に対して高周波重畳による摂動を与えても、波長選択素子20による選択波長以外の波長での発振は観察されず、発振波長を安定に制御することができた。

[0095]

このようにレーザービーム11を第2高調波15に変換して出力する場合は、第2高調波出力が基本波出力の2乗に比例するという事情があるため、半導体レーザーチップ10の発振波長変化に起因するモードホップによって第2高調波出力が特に大きく変動したり、駆動電流対第2高調波出力特性の再現性が著しく不良となりやすいが、本実施形態ではこの発振波長の変化やモードホップを確実に抑制できるから、第2高調波15の出力変動等を防止できる効果が特に高いものとなる。

# [0096]

次に、上記第3実施形態のレーザー光源を実装してなる光源装置について、その概略側面形状を示す図10を参照して説明する。図示される通り本光源装置において、半導体レーザーチップ10および波長選択素子20は、それぞれ銅等の熱伝導性の高い金属からなるブロック41、42に保持されている。また光波長変換素子30も、銅等の熱伝導性の高い金属からなるブロック43に保持されている。そして金属ブロック42を固定した金属ブロック41がさらに金属ブロック43に固定され、この金属ブロック43がペルチェ素子50の上面(温度制御面)上に固定されている。波長選択素子20によって選択される波長は素子の温度によって変化し、それにより半導体レーザーチップ10の発振波長が変化するので、それを防ぐために、上述のように外部共振器を構成する素子を温度調節することが好ましい。

#### [0097]

光波長変換素子30の端面30 a からは、この光波長変換素子30に基本波として入力されたレーザービーム11と第2高調波15とが出射するが、レーザービーム11は、コリメーターレンズ45とビームスプリッタ46との間に配された基本波カットフィルタ47によってカットされる。したがってこの場合は、ビームスプリッタ46により一部分岐された第2高調波15の光強度が光検出器51によって検出され、半導体レーザー駆動制御回路54により、第2高調波15の光強度が所定の値となるように半導体レーザーチップ10の駆動が制御される。

#### [0098]

なお本例の光源装置において、基本波としてのレーザービーム11の波長は1060 n mであるので、第2高調波15は波長が530 n mの緑色光となる。勿論、波長はそれに限られるものではなく、その他例えば波長470 n mの青色光が必要とされ

る場合は、940nmにゲインピークを有する半導体発光素子、選択波長が940nmである波長選択素子、および波長変換の位相整合波長許容幅に940nmを含んでいる光波長変換素子を用いればよい。

[0099]

次に図11を参照して、本発明の第4の実施形態によるレーザー光源について 説明する。図示されるようにこの第4の実施形態のレーザー光源は、図1の装置 で用いられたものと同様の波長選択素子20と、図1の装置で用いられた半導体レ ーザーチップ10と類似した半導体レーザーチップ10'とが直接結合されてなるも のである。

[0100]

半導体レーザーチップ10'は図1の半導体レーザーチップ10と比較すると、ストライプ12'が途中で曲がった形状とされている点、および、波長選択素子20と反対側の素子端面10bに、発振波長1060nmに対する反射率が5~30%程度であるLR(低反射)コートが施されている点が異なるものである。

[0101]

ストライプ12' は上述のように途中で曲がった形状とされて、素子端面10 bに対しては垂直となっている。またこのストライプ12' の素子端面10 a に対する傾き角は、図1の半導体レーザーチップ10におけるストライプ12の傾き角と同じである。つまり、このストライプ12' を導波する光と波長選択素子20のチャンネル光導波路22を導波する光との間でスネルの法則が満足されるようになっている。

[0102]

この構成のレーザー光源においては、半導体レーザーチップ10'から発せられた光の一部が素子端面10bで反射して、進行して来た方向と反対方向に折り返す。そこで、この素子端面10bと波長選択素子20のDBRグレーティング23とによって外部共振器が構成される。そして発振波長は、DBRグレーティング23による選択波長に選択、ロックされる。このようにして発振したレーザービーム11は、半導体レーザーチップ10'の素子端面10bから出射する。

[0103]

本レーザー光源においても、半導体レーザーチップ10'の端面10aおよび波長

選択素子20の端面20 a にARコートが施され、また半導体レーザーチップ10'の 端面10 a に対してストライプ12'が斜めに形成されているので、実質的に、半導 体レーザーチップ10'の両端面10 a、10 b 間でファブリペローモードが立つこと がなくなる。

#### [0104]

次に図12を参照して、本発明の第5の実施形態によるレーザー光源について 説明する。図示されるようにこの第5の実施形態のレーザー光源は、図1の装置 で用いられたものと同様の波長選択素子20と、図1の装置で用いられた半導体レ ーザーチップ10と類似した半導体レーザーチップ10"と、図7の装置で用いられ た光波長変換素子30と類似した光波長変換素子30'と、上記と同様の波長選択素 子20とがこの順に直接結合されてなるものである。

# [0105]

半導体レーザーチップ10"は図1の半導体レーザーチップ10と比較すると、ストライプ12"が途中で2箇所曲がった形状とされている点が異なるものである。ストライプ12"のチップ端面10a側の端部の角度は、このストライプ12"を導波する光と波長選択素子20のチャンネル光導波路22を導波する光との間でスネルの法則が満足される角度とされている。またストライプ12"のチップ端面10b側の端部の角度は、このストライプ12"を導波する光と光波長変換素子30′のチャンネル光導波路32を導波する光との間でスネルの法則が満足される角度とされている。

# [0106]

一方光波長変換素子30'は、図7の装置で用いられた光波長変換素子30と比較すると、素子端面30 a が斜めにカットされていない(つまりチャンネル光導波路32に対して垂直に形成されていない)点、および、この端面30 a に発振波長に対するARコートが施されている点が異なるものである。

#### [0107]

この構成のレーザー光源においては、半導体レーザーチップ10"から左右両方向に発せられた光の一部がそれぞれ2つの波長選択素子20のDBRグレーティング23で反射回折する。つまり本例では、2つの波長選択素子20,20のDBRグレ

ーティング23,23によって外部共振器が構成される。そして発振波長は、DBR グレーティング23,23による選択波長に選択、ロックされる。

# [0108]

このようにして発振したレーザービーム11は、光波長変換素子30'によって波長が1/2の第2高調波15に変換される。光波長変換素子30'の半導体レーザーチップ10"側の端面30bには、この第2高調波15に対してはHRでレーザービーム11に対してはARとなるコートが施されており、第2高調波15は図中右側の波長選択素子20の端面20bから出射する。

# [0109]

本実施形態のレーザー光源においても、半導体レーザーチップ10"の端面10 a および波長選択素子20の端面20 a に発振波長に対するARコートが施され、また半導体レーザーチップ10"の端面10 b および光波長変換素子30'の端面30 b にも発振波長に対するARコートが施され、その上、半導体レーザーチップ10"の端面10 a および10 b に対してストライプ12"が斜めに形成されているので、実質的に、半導体レーザーチップ10の両端面10 a、10 b 間でファブリペローモードが立つことがなくなる。

#### [0110]

本実施形態において、2つの波長選択素子20のDBRグレーティング23の選択 波長幅はFWHM(半値全幅)でともに0.12nmである(図4(a)参照)。このよう な波長選択素子20を半導体レーザーチップ10"の両側に配置すると、総合した波長特性は図4(a)の波長特性を2乗したものとなるため、選択波長幅は0.1nmと なる(図4(b)参照)。また、半導体レーザーチップ10"等の半導体発光素子の 両側に配置する波長選択素子の選択中心波長を互いに0.数nm程度僅かにずら すことによってさらに狭帯域化できるなど、2つの波長選択素子を用いる場合は、設計の自由度を大きくできるという利点がある。

#### [0111]

なお、以上説明のようにストライプ12"が途中で2箇所曲がった形状とされた 半導体レーザーチップ10"は、先に説明した図1の第1の実施形態において、半 導体レーザーチップ10に代えて用いることも可能である。その場合は、第2の波 長選択素子120のチャンネル光導波路122の傾きを反対、つまり図1において右上がりとなる傾きにすればよい。これは、図6の第2の実施形態や図7の第3の実施形態についても同様である。

# [0112]

次に図13を参照して、本発明の第6の実施形態によるレーザー光源について説明する。図示されるようにこの第6の実施形態のレーザー光源は、図12の装置において、半導体レーザーチップ10"およびその左側の波長選択素子20に代えて、1つの半導体レーザーチップ10′が適用された形のものである。この半導体レーザーチップ10′は、図11の装置におけるものと同様のものである。

# [0113]

そして上記半導体レーザーチップ10'の光波長変換素子30'側の端面10 a とその反対側の端面10 b にはそれぞれ、発振波長に対するARコート、HRコートが施されている。また光波長変換素子30'の両端面30 a , 30 b および波長選択素子20の両端面20 a , 20 b には、発振波長に対するARコートが施されている。それにより本装置においては、半導体レーザーチップ10'の上記端面10 b と波長選択素子20のDBRグレーティング23とによって外部共振器が構成されている。

#### [0114]

本実施形態において、半導体レーザーチップ10'、光波長変換素子30'および波長選択素子20の素子長はそれぞれ0.75mm,10mmおよび5mmである。また外部共振器の縦モード間隔は約0.02nm、DBRグレーティング23の選択波長幅はFWHM(半値全幅)で0.12nm、光波長変換素子30'の波長変換における位相整合許容波長幅は同様に0.12nmである。本例においては、基本波であるレーザービーム11の発振波長が、この波長変換における位相整合許容波長幅内で安定しているので、安定した出力の第2高調波15を得ることができる。

#### [0115]

また、本実施形態のレーザー光源を高周波重畳駆動した場合は、第3実施形態のレーザー光源と同様に、広い駆動電流範囲で安定したマルチモード発振を実現でき、またモードホップによる不連続な出力変化も抑制されて、安定した出力を得ることができる。

# [0116]

次に図14を参照して、本発明の第7の実施形態によるレーザー光源について 説明する。図示されるようにこの第7の実施形態のレーザー光源は、図13の装 置において、波長選択素子20と光波長変換素子30'の配置位置が逆にされた形の ものである。したがって本装置でも、半導体レーザーチップ10'の端面10bと波 長選択素子20のDBRグレーティング23とによって外部共振器が構成されている 。このような形態でも、基本的に図13の装置におけるのと同様の効果を得るこ とができる。

# [0117]

次に図15を参照して、本発明の第8の実施形態によるレーザー光源について 説明する。図示されるようにこの第8の実施形態のレーザー光源は、図11の第 4実施形態の装置に、半導体レーザーチップ10'と直接結合する光波長変換素子 30"が付加された形のものである。

# [0118]

光波長変換素子30"は、基本的には図7に示した光波長変換素子30と同様の構成を有するものであるが、そのチャンネル光導波路32は素子端面30bに対して垂直となるように形成されている。また、この光波長変換素子30"の別の端面30aは、チャンネル光導波路32に対して斜めにカットされている。

# [0119]

半導体レーザーチップ10'および波長選択素子20の各端面には、図11の装置におけるものと同様のコートが施されている。一方、光波長変換素子30"の半導体レーザーチップ10'と直接結合する端面30bには、基本波としてのレーザービーム11に対してARで、第2高調波15に対してHRとなるコートが施されている。また光波長変換素子30"の反対側の端面30aには、レーザービーム11に対してHRで、第2高調波15に対してLRとなるコートが施されている。

#### [0120]

このレーザー光源においても、半導体レーザーチップ10'の端面10bと波長選択素子20のDBRグレーティング23とによって外部共振器が構成される。そして発振したレーザービーム11は光波長変換素子30"に入射して第2高調波15に変換

され、この第2高調波15が光波長変換素子30"の端面30aから出射する。

# [0121]

本装置においても、発振波長および出力の安定化等については、図11の第4 実施形態の装置におけるのと同様の効果が得られる。また本装置では、光波長変 換素子30"の光出射側の端面30 a が、その光導波路32の延びる方向に対して斜め にカットされているので、この端面30 a で反射した光が光導波路32に再入射する ことがなくなる。そうであれば、この再入射した光が半導体レーザーチップ10' にいわゆる戻り光となって入射することがなくなるので、この戻り光によるノイ ズの発生や出力変動の問題を防止することができる。

#### [0122]

次に図16を参照して、本発明の第9の実施形態によるレーザー光源について説明する。図示されるようにこの第9の実施形態のレーザー光源は、図11および図15の装置で用いられたものと同様の半導体レーザーチップ10'と、この半導体レーザーチップ10'の後方端面10aから発散光状態で出射したレーザービーム11を平行光化するコリメーターレンズ70と、平行光となったレーザービーム11を集光レンズ71と、この集光レンズ71によるレーザービーム11の収束位置に配されて該レーザービーム11を反射させるミラー72と、上記コリメーターレンズ70と集光レンズ71との間に配された狭帯域バンドパスフィルター73とから構成されている。

# [0123]

半導体レーザーチップ10'の後方端面10a、前方端面10bにはそれぞれ、発振波長に対するARコート、LRコートが施されている。またストライプ12'の後方端面10aに近い部分は、この端面10aに対して斜めに形成されている。そしてこのストライプ12'は途中で曲げられて、前方端面10bに対しては垂直となるように形成されている。

#### [0124]

上記の構成においては、ミラー72で反射したレーザービーム11が半導体レーザーチップ10'に戻され、そしてその際該レーザービーム11は狭帯域バンドパスフィルター73によって波長選択されるので、発振波長がこの選択された波長にロッ

クされる。

[0125]

そしてこの場合も、半導体レーザーチップ10'の後方端面10 a に発振波長に対するARコートが施された上で、該後方端面10 a に対してストライプ12'が斜めに形成されていることにより、半導体レーザーチップ10'の両端面間でファブリペローモードが立つことが抑制され、既述の各実施形態におけるのと同様の効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1実施形態によるレーザー光源を示す概略平面図

【図2】

上記第1実施形態のレーザー光源における駆動電流値対光出力特性(1)と、発振スペクトル(2)を概略的に示すグラフ

【図3】

上記第1実施形態のレーザー光源を髙周波重畳駆動した際の駆動電流値対光出力特性(1)と、通常動作時の発振スペクトル(2)と、モード切り替わり時の発振スペクトル(3)とを概略的に示すグラフ

【図4】

上記第1実施形態のレーザー光源に用いられた導波路型波長選択素子の波長選択特性を示すグラフ

【図5】

上記第1実施形態のレーザー光源を実装してなる光源装置の一部破断側面図 【図6】

本発明の第2実施形態によるレーザー光源を示す概略平面図

【図7】

本発明の第3 実施形態によるレーザー光源を示す概略平面図

【図8】

上記第3実施形態のレーザー光源を高周波重畳駆動した際の駆動電流値対光出 力特性を概略的に示すグラフ 【図9】

上記第3実施形態のレーザー光源を高周波重畳駆動した際の発振スペクトルを 概略的に示すグラフ

【図10】

上記第3実施形態のレーザー光源を実装してなる光源装置の一部破断側面図【図11】

本発明の第4 実施形態によるレーザー光源を示す概略平面図

【図12】

本発明の第5実施形態によるレーザー光源を示す概略平面図

【図13】

本発明の第6実施形態によるレーザー光源を示す概略平面図

【図14】

本発明の第7実施形態によるレーザー光源を示す概略平面図

【図15】

本発明の第8実施形態によるレーザー光源を示す概略平面図

【図16】

本発明の第9実施形態によるレーザー光源を示す概略側面図

【図17】

従来のレーザー光源の一例を示す概略平面図

【図18】

図17のレーザー光源における駆動電流対光出力特性を概略的に示すグラフ

【図19】

図17のレーザー光源の低出力時(1)および高出力時(2)の発振スペクトルを概略的に示すグラフ

【符号の説明】

10、10'、10" 半導体レーザーチップ

10 a 、10 b 半導体レーザーチップの端面

11 レーザービーム

12 半導体レーザーチップのストライプ

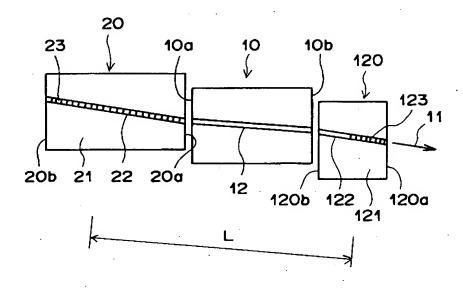
- 15 第2高調波
- 20、120 導波路波型長選択素子
- 20a、20b、120a、120b 波長選択素子の端面
- 21、121 SiO<sub>2</sub>基板
- 22、122 波長選択素子の光導波路
- 23、123 DBRグレーティング
- 30、30"、30" 光波長変換素子
- 30 a 、30 b 光波長変換素子の端面
- 31 MgO-LN基板
- 32 光波長変換素子の光導波路
- 33 ドメイン反転部
- 41、42、43 金属ブロック
- 45 コリメーターレンズ
- 46 ビームスプリッタ
- 47 基本波カットフィルタ
- 50 ペルチェ素子
- 51 光検出器
- 52 サーミスタ
- 53 温度制御回路
- 54 半導体レーザー駆動制御回路
- 60 パッケージベース
- 61 パッケージカバー
- 62 窓ガラス
- 70 コリメーターレンズ
- 71 集光レンズ
- 72 ミラー
- 73 狭帯域バンドパスフィルター
- 130、130'、130"光導波路素子
- 130 a 、130 b 光導波路素子の端面

- 131 MgO-LN基板
- 132 光導波路素子の光導波路

【書類名】

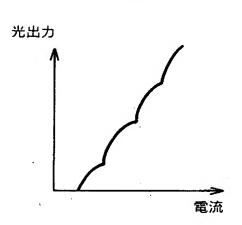
図面

【図1】

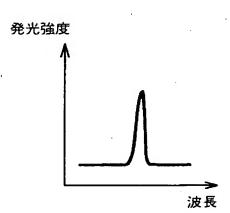


【図2】

(1)

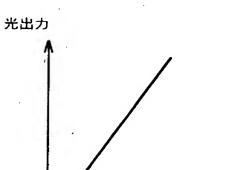


(2)



【図3】,

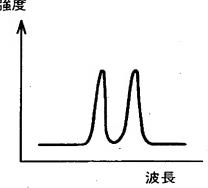
(1)



電流

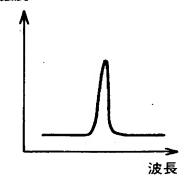
(3)

発光強度

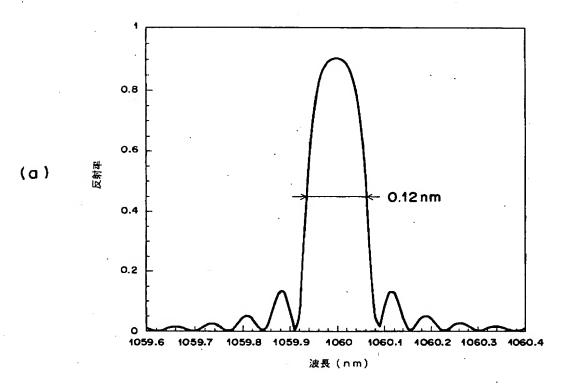


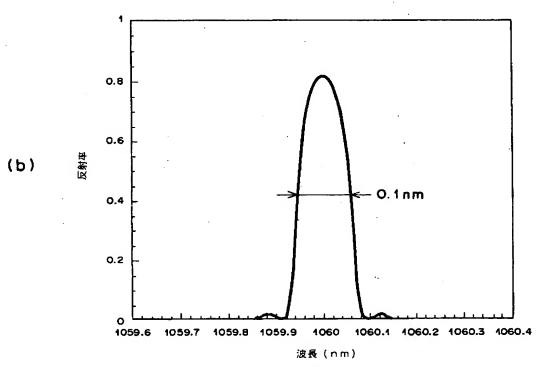
(2)

発光強度

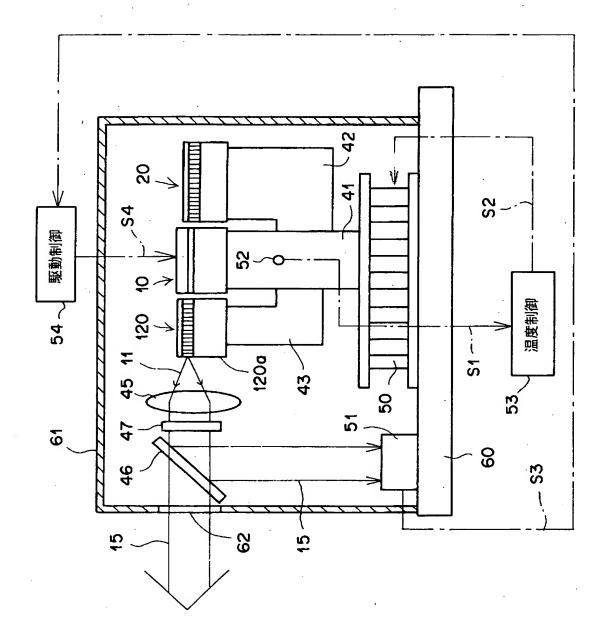


【図4】

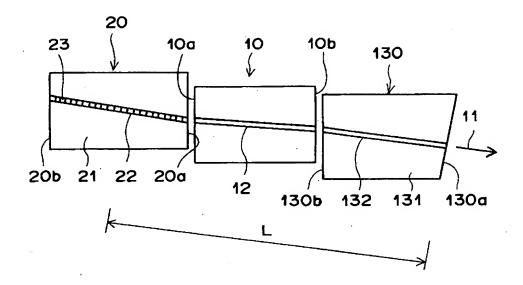




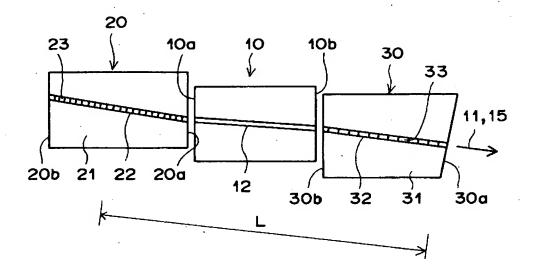
【図5],



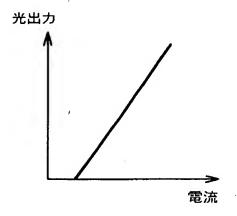
【図6】



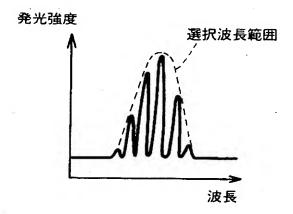
## 【図7】



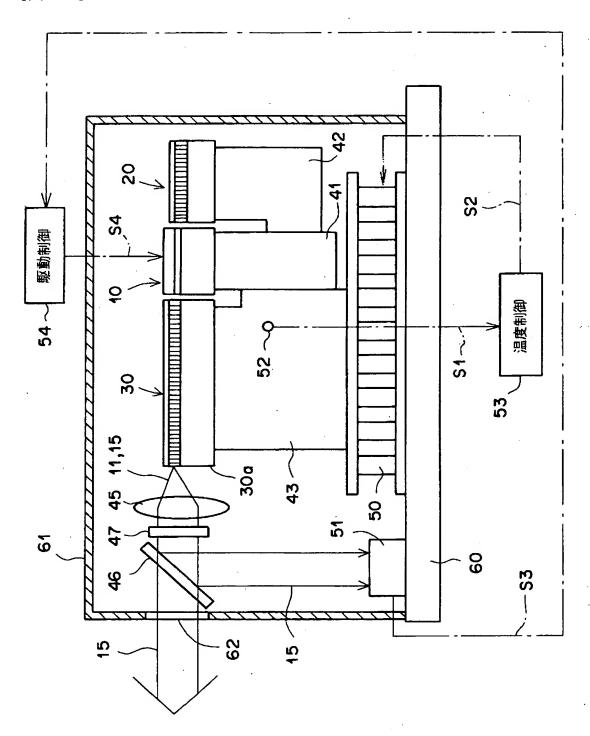
【図8】,



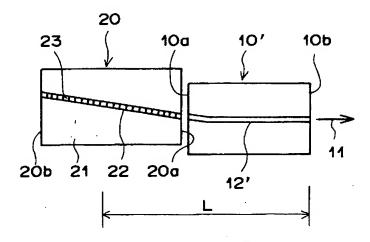
【図9】



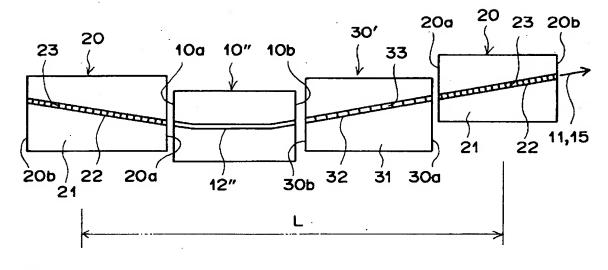
【図10】



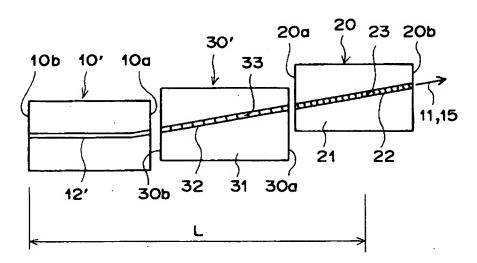
【図11】



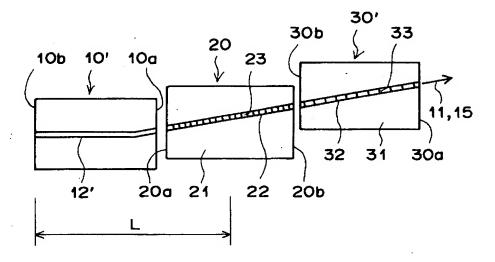
【図12】



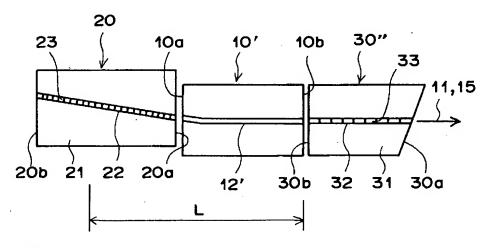
【図13】



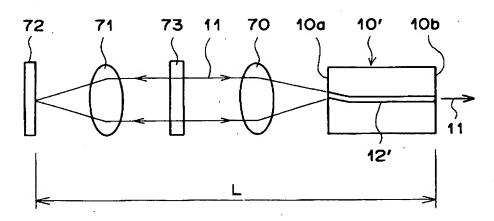
【図14】



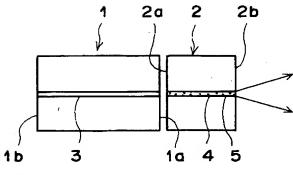
【図15】



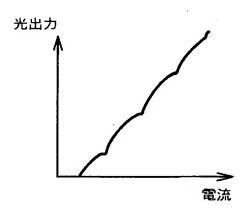
【図16】



【図17】



【図18】

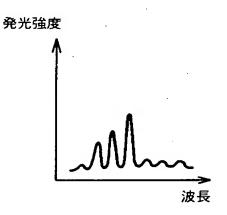


【図19】

(1)

発光強度

(2)



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 半導体発光素子と、この半導体発光素子から発せられた光の波長を 選択する波長選択素子を含む外部共振器とから構成されるレーザー光源を、選択 された波長で安定して発振可能とする。

【解決手段】 半導体発光素子10と、そこから発せられた光の波長を選択する第1の波長選択素子20および第2の波長選択素子120を有し、例えばこれらの波長選択素子20、120によって外部共振器が構成されたレーザー光源において、半導体発光素子10の劈開された2つの端面のうち外部共振器を構成しない端面10a、10bに対して、該半導体発光素子10のストライプ12を斜めに形成し、この外部共振器を構成しない端面10a、10bに、発振波長に対する反射防止コートを施す

【選択図】

図 1

## 認定・付加情報

特許出願の番号

特願2000-372286

受付番号

50001577049

書類名

特許願

担当官

第五担当上席

0094

作成日

平成12年12月 8日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成12年12月 7日

【特許出願人】

【識別番号】

000005201

【住所又は居所】

神奈川県南足柄市中沼210番地

【氏名又は名称】

富士写真フイルム株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100073184

【住所又は居所】

神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-20 B

ENEX S-1 7階 柳田国際特許事務所

【氏名又は名称】

柳田 征史

【選任した代理人】

【識別番号】

100090468

【住所又は居所】

神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-20 B

ENEX S-1 7階 柳田国際特許事務所

【氏名又は名称】

佐久間 剛

## 出願人履歴情報

識別番号

[000005201]

1. 変更年月日

1990年 8月14日

[変更理由]

新規登録

住 所

神奈川県南足柄市中沼210番地

氏 名

富士写真フイルム株式会社